

胜蓝股份 20260825

数通 224G 授权进入放量期，对标安费诺开启高增长拐点

摘要

- 营收与业务结构：2026H1 营收 11.3 亿元（+46%），通过对标安费诺布局消费电子、新能源、数通、工业互联四大产品线，实现从标准件向高毛利定制件转型。
- 数通业务爆发：2026H1 营收超 1 亿元实现倍增；获 Molex 独家授权 224G 超节点连接器（含背板与 CX2 方案），预计 2026Q3-Q4 开始供货并贡献显著业绩。
- 核心客户订单：已获 A 客户数年期中标通知，首批 600+ 机柜订单将于 2026.09 至 2027.03 交付；2027 年需求预期较原招标量增长数倍，单机柜价值量约 10 万美元。
- 产能与良率：已投建 3 条自动化线，单线年产能 1,200 机柜，预计 2027Q1 稳定产出；当前良率 50%-60%，目标提升至 85%+，届时净利率有望超 20%。
- 液冷业务布局：布局快接头、水冷板等全套方案，800G 液冷壳已放量，1.6T 产品 2026Q4 有望放量；预计 2026 年底液冷业务贡献数千万元营收。
- 竞争壁垒与策略：凭借国内唯一 224G 授权卡位高端市场，通过一次性及按批次支付专利费模式与 Molex 深度绑定，作为第二供应商切入全球头部 CSP 供应链。

Q&A

2026 年上半年公司业绩增长显著，尤其是在消费电子和新能源汽车行业面临压力的情况下。请问业绩增长主要由哪些新业务或新客户驱动？同时，如何展望下半年消费电子和新能源汽车等传统主营业务的经营情况？

2026 年上半年，公司整体营收达到 11.3 亿元，同比增长约 46%。业绩增长主要得益于产品结构的调整和新业务的拓展。公司学习行业头部企业安费诺的模式，布局了消费电子（智能与终端）、新能源（光伏、储能、充电）、数据与通讯、工业互联四大产品线。在消费电子领域，尽管行业整体下滑，但公司实现了显

著增长。这主要归因于：首先，从 2025 年开始，公司主动削减了竞争激烈、利润空间小的标准接口手机类项目，转向技术要求和毛利率更高的产品，如防水连接器。其次，公司成功拓展了低空经济业务，国内最大的低空经济厂商已成为公司在该领域的核心客户，该业务预计 2026 年全年营收将超过 2 亿元，仅上半年就贡献了约八九千万元的收入，成为消费电子板块的重要增量，且毛利率较高。此外，公司通过引入新设备和开发新模具等降本增效措施，提升了老产品的生产效率，以对冲原材料价格上涨的影响。在新能源汽车领域，公司的客户群体主要为国内头部企业，订单量相对稳定。为提升盈利能力，公司从 2025 年开始调整产品结构，将部分铜排等低附加值产品，升级为带滤波器的、结构更复杂的集成化产品。这一调整使得新产品的单价更高，虽然汽车产品整体毛利率不高，但在行业竞争加剧的环境下，新产品的毛利率仍能维持在十几个点的水平。新产品的放量效应在 2026 年第二季度已初步显现，预计在第三、四季度将对利润产生更明显的贡献。在数据与通讯领域，2026 年上半年业务实现了倍增，营收达到一个多亿。这部分增长主要来自 2025 年开始认证并于今年逐步放量的产品，包括光模块的笼子、AEC/DAC 线缆、数据中心的 Busbar 以及部分液冷产品。该业务板块的毛利水平相对较好，竞争格局也较为有利。在工业互联领域，该业务尚处于培育阶段，目前营收贡献较小，约为小几千万元。公司已设立募集项目专项投入，并从 2025 年开始布局产品线，以应对未来工业机器人和家用机器人的市场需求。目前已进入部分国内大型工业企业的供应链，预计未来几年将逐步释放业绩。

关于数据与通讯业务，2026 年上半年一个多亿的收入是否包含了与特定客户（如 A 客户）在 224G 超节点连接器授权方面的合作？这部分授权产品的业绩预计何时开始释放？

2026 年上半年一个多亿的收入主要来源于传统的数据通讯产品，如光模块 cage、AEC、DAC 线缆、Busbar 及少量液冷产品，这些是 2025 年认证通过后在今年上半年开始放量的。与 A 客户合作的授权产品，即 224G 超节点的背板连接器和近芯片封装的 CX2 连接器，其业绩尚未在半年报中体现。公司于 2026 年第一季度获得授权，第二季度进行产品开发，目前已进入小批量产出阶段，预计在本月底（2026 年 8 月底）至下个月（2026 年 9 月）开始供货。因此，这部分授权产品的业绩贡献预计将在 2026 年第三、四季度开始显现，并将在未来几年内实现快速增长。

公司获得的 224G 超节点连接器授权包含背板方案和近芯片封装的 CX2 方案，这两种技术路线有何具体区别？未来其他潜在客户（如字节、腾讯等）可能会倾向于选择哪种方案？

公司获得了 Molex 授权的一整套 224G 传输速率解决方案，包括名为 Inception 的背板连接器和名为 CX2 DS 的近芯片封装连接器，该方案未来可升级至 448G。这两种方案的技术路线有所不同。CX2 是一种近芯片封装（near-chip co-packaged）方案，其上一代产品是基于 PCB 的形态。由于 PCB 方案存在损耗、

成本和交付周期等方面的限制，海外的英伟达、谷歌等公司已开始转向采用新的近芯片封装方案。目前，国内受限于芯片制造工艺，传输速率尚未达到 224G 的水平，但包括 A 客户、Z 客户及其他互联网头部企业均已在进行相关的预研和投入。2026 年是预研年，预计从下半年到 2027 年，超节点产品的需求将快速增长。获得这两项核心专利授权后，也加速了公司其他周边产品线的客户认证进程。例如，一些高附加值的 AEC、DAC、OSFP 以及液冷 cage 等产品，得以进入快速认证通道。

请介绍公司在服务器内部互联产品方面的布局，特别是 CX2 和背板产品的技术特点、应用场景以及当前的市场竞争格局是怎样的？

公司目前专注于服务器柜内互联产品，主要连接从芯片端到服务器周边设备。与服务器外部的光连接产品（已有布局但尚未产生业绩）不同，柜内互联的核心产品之一是 CX2，它紧邻芯片周边，负责信号的传出。在 112G、224G 乃至未来 448G 的高速传输需求下，传统的 PCB 板方案因损耗、功耗和信号完整性问题已无法满足技术要求，且成本较高。因此，主流应用厂商转向了新的近芯片封装方案，即 C2C（Chip-to-Chip）。C2C 方案通过线缆和接口将芯片信号引出，可连接至多种设备，例如名为 Inception 的 224G 背板、实现芯片间互联的 C2C 对 C2C 连接、连接至安费诺的 Overpass 类产品，或连接至光模块（如 OSFP）。这种热插拔光模块的形态，其信号从芯片引出都需经过 C2C 线缆和接口。该技术在海外存在专利壁垒，国内企业目前难以规避且尚无厂商能够生产。另一关键产品是背板，被誉为行业“皇冠上的明珠”，其制造工艺和难度极高。在当前的超算节点机柜中，对背板的用量和一致性要求非常严苛，导致整体产品良率偏低。全球市场主要由安费诺和莫仕主导，其中安费诺占据超过 80% 的市场份额，这也是其近年来业绩、利润及市值大幅增长的核心驱动力；莫仕的份额约为 10% 左右；泰科虽有涉足，但在 112G 和 224G 产品上布局不多。国内市场方面，立讯精密也有所布局。对于国内头部的算力企业而言，在选择供应商时，基本局限于这几家厂商，可选项非常有限。

公司目前向主要互联网客户 A 供应的产品具体是什么？是 CX2 加 Inception 背板的整体方案吗？以及这套方案在机柜中的价值量大概是多少？

公司当前为该客户提供的是一套 CX2 加 Inception 背板的组合方案，这是客户自主选定的技术路线，公司作为国产厂商以第二供应商的身份参与供应，该客户选择的原始方案来自莫仕。具体应用上，CX2 部署在 GPU 芯片的周边，用于引出芯片的信号和功能；信号引出后，通过线缆连接到机柜后部的 Inception 背板上，该背板在整个机柜后方呈一整排部署。关于价值量，整套方案在一个机柜中的价值大约在十万美元左右。

关于当前已获取的订单，具体的交付计划是怎样的？客户对未来的需求预期是否有新的变化，以及公司为此做了哪些产能规划？

公司已获得一份为期数年的中标通知书，首批订单对应约 600 多个机柜，交付周期将跨越客户的一个财年（至 2027 年 3 月）。公司已向客户承诺了明确的产能爬坡计划，将从 2026 年 9 月开始，分月交付直至 2027 年 3 月完成。近期，由于客户在芯片、内存等方面的需求增加，对方给出了一个覆盖到 2027 年年底的需求预期，该预期量相比原招标量增长了好几倍。为应对此需求，公司已投资建设了三条自动化产线和一条半自动化产线。单条自动化产线月产能约为 98 个机柜，年产能约 1,200 个机柜。目前三条产线将在 2026 年 9 月底至年底前陆续到位，并进行产能爬坡，预计到 2027 年一季度可实现稳定产出。公司已向客户承诺将总共布局 5 到 6 条产线，剩余 2 到 3 条产线的扩产计划预计在 2026 年年底或 2027 年一季度明朗化，具体将根据客户的订单释放情况来决策下单。设备扩产周期较快，约 3 到 4 个月即可形成产能。

客户对 2027 年的需求预期是基于现有订单基础上的增量吗？后续的订单是否需要重新招标？

客户给出的 2027 年全年需求预期，确实比当前已确定的订单量大好几倍，但目前这只是一个预期，尚未转化为正式订单。由于此次中标是基于整个项目进行的，因此后续的需求释放无需重新招标，客户可根据实际需求直接下达订单。目前客户的需求与芯片供应情况密切相关，他们自身也存在不确定性，但从近期公开发布的信息来看，其 2027 年的资本开支预计会比较大。基于客户给出的需求预测，公司已做出了相应的产能扩充承诺，目前三条产线可满足全年 3,600 个机柜的产能，未来增加产线后产能将进一步提升。具体的扩产行动将等待客户的订单正式释放。

除了现有客户，公司与其他几家互联网公司的业务对接进展如何？对于潜在的、规划量更大的客户，目前处于哪个阶段？

公司与其他互联网公司客户仍在正常对接过程中。其中，规划量较大的那家潜在客户目前尚处于方案选型阶段，因此具体方案尚未最终确定。公司已有部分周边的连接器产品进入了该客户的供应链体系，当前重点推荐的是高速、高附加值的产品线。由于客户选型仍在进行，目前无法确定具体的时间表。

对于这类大型互联网客户，他们在选择高速连接器供应商时，主要会考虑哪些因素？性能、商务关系还是其他方面？

此类全球级客户在选择供应商时，首要考虑的是合规性，即供应商必须拥有自主知识产权或获得合法授权，这是参与竞争的前提。其次是产品性能，需要经过大规模应用的验证。海外厂商中，安费诺和莫仕的产品已得到广泛验证；国内厂商中，立讯精密的产品也具备竞争力。最终选择取决于客户，他们会综合考量供

应的稳定性以及未来的迭代研发能力。这类产品的迭代速度很快，需要供应商具备持续跟进的能力。例如，该潜在客户在上一代 56G 产品上使用的是莫仕的方案，但新一代产品会选择哪家供应商尚不确定。产品的制造难度极高，一个机柜内有数万根线缆，任何一根出现问题都可能导致数据失真或丢包，这是无法容忍的。因此，客户通常会进行很长的验证和测试周期，往往需要提前一年开始进行预研开发。这也是为什么另一家国产芯片尚未达到 112G 速率的客户，会提前选用 224G 接口界面的原因，旨在为未来芯片升级后的无缝切换做好准备，避免大规模更换基础架构。

关于近期对接的新客户，其超算节点方案（无论是 64 卡还是 256 卡）是否明确会使用 224G 连接器？目前项目交流到了什么阶段？

目前与该客户的交流仅限于项目层面，尚未进入正式招标阶段。客户仅表达了对特定速率产品的需求，并询问了相关的专利和制造能力，但并未透露该产品将应用于何种具体环境、GPU 卡数或超算节点类型。因此，尚不清楚其 64 卡或 256 卡方案是否会采用 224G 连接器。

如果新客户最终选择安费诺作为主供应商，公司是否有机会通过与安费诺达成技术授权合作，成为其第二供应商？目前与安费诺就此事有无实质性交流？

理论上，公司有机会争取成为安费诺的第二供应商。公司与安费诺、莫仕、泰科等行业主要厂商均保持着长期且紧密的合作关系，因此会积极争取获得授权的机会。不过，目前客户仍处于主要方案的选型阶段，尚未进展到确定第二供应商的步骤，所以公司与安费诺之间还未就此授权事宜展开实质性交流。尽管如此，基于过往的合作与相互认可，公司相信获得授权的机会很大，尤其是在决策效率和执行速度方面具备优势。

公司从获得专利到实现产能，整个过程的效率如何？目前客户对产品和产线的反馈是怎样的？

公司从决定购买专利、投入研发到扩大产能，整个过程仅用时数月便已完成，并形成了实质性能。近期客户在参观产线、检验产品并审阅数据报告后，对产品本身已无疑问，认为产品的数据和参数表现良好，对公司能如此迅速地完成产品开发和实现量产表示认可。当前的工作重心已转向产能扩张和提升产出效率。

目前 224G 连接器的生产良率水平如何？未来的提升目标是多少？

当前的生产良率在 50%至 60%之间，这已超出了最初按低于 50%进行的预估。在行业内，对于新产品而言，这是一个较高的初始水平。随着自动化设备的投入，良率预计将进一步上升。公司的目标是参照行业内领先厂商的水平，将良率提升至 85%甚至更高。良率的提升将直接促进毛利率的增长。

在当前五至六成的良率水平下，预计产品的净利率能达到多少？如果良率提升至 85%以上，净利率预计会达到什么水平？

目前尚未进行非常精细的测算，但努力的目标方向是实现 20%以上的净利率。如果良率能够成功提升至 85%以上，理论上净利率会超过 20%。由于 Molex 本身的产品定价不会过低，以支撑其高昂的研发投入，因此产品毛利空间较为可观。不过，在实现大规模批量生产前，还无法得出稳定且精确的测算结果。

公司在液冷业务方面的整体布局和产品线是怎样的？今年的收入目标和产能规划如何？

公司基于在机加工领域的优势，布局了散热业务，主要包括散热模组、水冷快接头、水冷板（铜质与不锈钢）、分水器和波纹管四大产品线，这些产品可组合成整套散热解决方案。自 2025 年开始筹备，目前已通过送样和小批量订单，预计到 2026 年末，液冷业务将释放数千万元的营收。在产能方面，例如水冷快接头已布局了 40 万套的产能。公司采取“小步快跑”的策略，与行业头部客户和新技术保持紧密联系，利用在服务器连接器领域的客户基础推广液冷产品。团队核心成员来自行业顶尖企业，产线设备也对标领先厂商，获得了客户的高度认可。

在液冷业务中，哪些产品的进展较快？预计何时能实现规模放量？

目前光模块液冷散热壳和快接头的进展相对较快。液冷散热壳方面，800G 产品的出货量已较大，1.6T 产品预计在未来两个月内完成认证，可能在 2026 年第四季度开始放量。快接头是公司在液冷领域主推的产品，其制造工艺复杂，技术壁垒高。近期有几个代工项目正在洽谈，如果进展顺利，到 2026 年底可能产生数千万元的收入；若稍慢，则可能在 2027 年实现数千万至数亿元的产值。整体而言，液冷业务的大规模放量预计会在 2026 年底至 2027 年期间出现。

关于液冷 1.6T 光模块的连接器产品，目前与国内客户的合作进展如何？预计何时能推出样品？此外，该产品在海内外市场的业务模式有何不同，当前的验证进度和预计产生收入的时间点是怎样的？

目前正在为国内一家大型客户设计液冷 1.6T 光模块连接器，由于保密协议无法透露客户名称。该产品适配于 2x8 的光模块 cage，样品预计在 2026 年 9 月份完成，届时将根据客户仍在变化的散热方案进行适配和最终确定。在业务模式上，海外市场主要以代工为主；国内市场则主要是为海外厂商在华的业务提供零部件及成品配套。该产品的验证周期较长。目前已将样品送至多个重要客户进行测试，包括台湾、日本及其他海外地区的客户。由于该产品采用机加工工艺，不涉及模具开发，因此更侧重于长期的可靠性验证。公司在 2026 年上半年已对产品进行了大量的内部可靠性测试，包括氦检气密性、气压及多种极限测试，以确保获得充分的测试数据，支持客户进行下一阶段的测试。这是一个双重测试过程，所以时间周期较长。顺利的话，预计在 2026 年第四季度可以看到相关收入。该

产品的一大优势是其标准化特性，开发成功后可适用于多个客户，而非定制化产品。

请介绍一下泰国工厂的建设情况、当前产能以及主要业务布局？

公司于 2024 年在泰国罗勇府购买了 50 亩土地，并已建成约 3 万平方米的厂房。该地点邻近芭提雅和曼谷，海运交通便利。目前，泰国工厂的月产值约为七八百万元人民币，主要业务是为几家海外客户提供代工与合作服务。产品线覆盖了连接器、连接线以及数据线等多个品类。

与 Molex 的专利授权合作是否存在期限限制？未来是否存在客户转向与其他厂商合作的风险？

目前获得的专利授权没有设定明确的期限，但存在地域限制，当前授权范围仅限于国内交付。若未来需要在海外市场开展业务，需要向授权方再次申请扩大授权范围。关于授权给其他厂商的可能性，虽然理论上存在，但实际发生的概率极低。首先，Molex、安费诺等行业巨头通常倾向于在彼此之间进行相互授权，以形成全球供应的闭环，本身并不愿意向国内厂商授权。其次，Molex 在该产品上的研发投入已超过十亿人民币，此次授权是基于双方长期且协同效应强的合作关系，经过了多次深入沟通才达成的。原则上，授权方不会再授权给第二家国内厂商，因为这相当于引入一个新的市场竞争者来分割利润。若非客户强制要求在国内建立独立的第二供应商以保障供应链安全，这类授权本身就不会发生。Molex 在海外市场的份额相对安费诺较小，因此希望通过与国内合作伙伴验证其产品并拓展业务，这也是促成此次合作的背景之一。

公司未来的资本开支规划是怎样的？特别是在连接器产线扩张方面，预计投入多少资金，以及在设备采购上是否存在瓶颈？

目前单条产线的投入金额大约在 5,000 万至 6,000 万元之间。因此，未来的产线扩张将需要较大的资金支持。短期内的资金需求尚不紧缺，具体的扩产计划将依据明年（2027 年）及以后其他客户的认证进展以及现有 A 客户的需求情况来决定。在产能扩充方面，短期内不会遇到大的瓶颈。当前是一个有利的时间点，因为整个行业正从 56G 向 112G、224G 迭代，安费诺、Molex 等厂商的许多产线都集中在国内。经过近几年的发展，国内围绕该产业的自动化、材料、模具、机加工等配套厂商已经相当成熟和完整，供应链不存在单一厂商限制的问题。例如，过去非常昂贵的测试设备需要从海外少数几家厂商购买，而现在国产设备也已出现，解决了这一限制。目前唯一的 key 限制是专利问题，获得授权后，相当于获得了参与市场竞争的资格。

如果明年（2027 年）有新的 CSP 客户订单落地，公司在产能扩张方面能否及时响应客户的放量需求？

产能方面应该不会出现无法及时响应的情况。首先，客户会提前提供需求预测，例如近期已收到客户关于明年（2027 年）的前置需求。其次，公司已一次性投入建设了 3 条产线，本身具备较大的初始产能。在与客户的沟通中，也已明确承诺了明年（2027 年）的扩产意愿。具体的扩产启动时间点将根据客户芯片的放量情况来灵活安排，可能会在今年（2026 年）10 月、11 月，或是明年（2027 年）1 月、2 月开始执行。

公司的产线设备是由客户出资买断，还是属于公司自有资产？对于单线产能的界定，是依赖增加人力还是增加设备？

生产线设备均为公司自有资产，客户并未出资，因此不存在设备被买断或必须为特定客户服务的情况。当然，公司会根据客户订单的饱满程度做出承诺，如果某个客户的订单量足以覆盖整条或几条产线的产能，便会将这些产线专门拨给该客户使用，但这本质上不构成限制。

单条产线约 1,200 个 Cable Tray 的产能是如何界定的？是依据每日或每月的组装量，还是以人力来计算？

产能的测算是基于整个生产链条的最后一个节点。该生产链条包含多个工序，从端子、微波线，到使用自动机组装连接器，再到线材、cage box 的组装，最终形成 cable tray。其中，主要的瓶颈在于自动线的组装环节。因此，我们是依据自动线的整体产出量来计算产能，即根据其产出的线材数量能组装成多少个机柜来进行测算。

目前用于连接 CPU、GPU 的 AEC、DAC 等 SerDes 线缆是自产还是外购？

此类线缆为自主生产。此前产量较少，主要因为 AC/DC 芯片基本源于海外，且芯片成本占比高，导致国内厂商在方案受制于芯片时利润空间有限。鉴于线缆本身价值量也很高，为保障供应链稳定，我们投资了一家芯片企业。

在与莫仕的授权合作中，订单获取模式是怎样的？是莫仕分配订单，还是双方在同一平台直接竞争？

我们与莫仕同时向客户交付产品。在此合作中，我们向客户及莫仕承诺会承担一定的供应份额。

在获取客户订单时，是否必须先由莫仕获得订单，我们才能获得份额？还是说我们可以独立参与竞争？

通常情况下，客户会优先选择莫仕或安费诺，因为它们拥有自有专利产品。客户很少会直接选择国内厂商进行设计，因为方案中可能需要组合多种专利产品。莫仕和安费诺凭借其众多的专利产品组合，在这一领域形成了事实上的闭环。我们通过获得两项核心产品授权，当客户采用莫仕类型方案时，我们能够以第二供应商的身份参与，具体份额则视情况而定。我们的产品是直接交付给各大服务器厂商，而非其代工厂。

如果安费诺在某个客户中占据主导地位，是否会影响我们的市场份额？

目前我们获得的是莫仕的授权。如果安费诺在某个项目中占据主导，原则上我们仍会同台竞争，并在愿意投入的情况下，寻求获得安费诺的授权。我们与安费诺等行业领先企业保持着良好的互动关系，因此未来获得其授权的机会很大。此外，我们向莫仕承诺，在其海外产能不足时，我们可以为其供货，这也是莫仕选择与我们合作的原因之一。作为民营企业，我们的配合弹性较大，并且近年来与这些大厂的合作建立了良好的口碑。

国内 CSP 厂商（如 A 客户）要求强制第二供应商是促成此次授权的重要原因，请问其他 CSP 厂商是否存在同样要求？第二供应商的选择主导权在莫仕、安费诺还是 CSP 厂商？

理论上，所有客户，无论是 CSP 还是服务器代工厂，都拥有选择权。但在实际操作中，由于专利归莫仕所有，因此莫仕拥有更大的决策权。企业首先需要进入供应链名单，才能获得备选资格。在选择备选供应商时，会综合考量成本、投入意愿以及莫仕的倾向性。我们能获得授权，主要得益于近年来与莫仕良好的合作关系、莫仕对我们的信任，以及我们承诺在其海外供应紧张时提供补充产能，并且不会抢占其过多份额。

获得 224G 产品授权对于公司发展的战略意义是什么？

224G 产品授权对公司而言是一个拐点性的机遇。首先，该项目初期市场预期量不大，未受普遍重视，但我们积极参与并进行了激进的大力投入，获得了客户的认可。其次，通过此次合作，我们在行业内与莫仕、泰科（TE Connectivity）、安费诺等建立了良好口碑，并获得了国内唯一的 224G 授权，这为我们卡位了 112G、224G 及未来 448G 等几代产品，为未来几年的增长提供了确定性。这一成功案例也吸引了大量国内高级人才，包括业务、技术等领域的人才近几个月向我们聚拢，形成了正向循环。客户对我们快速且高质量的产品开发与制造能力给予了高度评价。获得授权相当于拿到了进入高端市场的“牌照”，使我们能与行业巨为市场供货。由于市场增量可观，尤其是大模型驱动的超级计算节点成为势，我们更看重的是进入这个“牌桌”的资格，而非单次份额的大小。我



通过与莫仕的深度合作，未来能获得更多高价值产品的专利授权。自 2026 年 3 月以来，我们已陆续获得其他几款未来主流接口产品的授权。

与莫仕的专利授权在利益分配上是如何安排的？

我们向莫仕一次性支付了一笔永久性的专利金，并获得了正式的授权合同与授权证书。此外，每交付一批次的产品，我们还需再向其支付一次专利费用，具体比例不便透露。

公司未来的整体发展方向是怎样的？

我们的发展战略是聚焦产品，全面对标并学习安费诺的产品布局、市场布局、客户布局及人才布局，致力于成为“中国的安费诺”。